LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI08_3+2+3_1,50

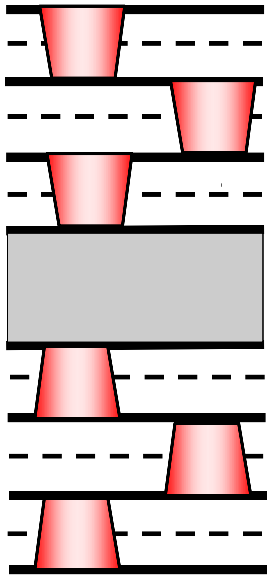
8 - Lagen

Kern: 0,93 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**3 + 2 + 3**
KUNDE:		

nur CBT Schopfheim

WÜRTH ELEKTRONIK



LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK2		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
3	VSK1		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
4	2			35 µm		33	
			0,930 mm			930	
5	3			35 µm		33	
					1 x 1080	60	
6	RSK1			12 µm		30	
					1 x 1080	60	
7	RSK2		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
8	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1500

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,12	mm	Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,15	mm		
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,17	mm		
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:	

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	Seite:	22+